

[illegible]

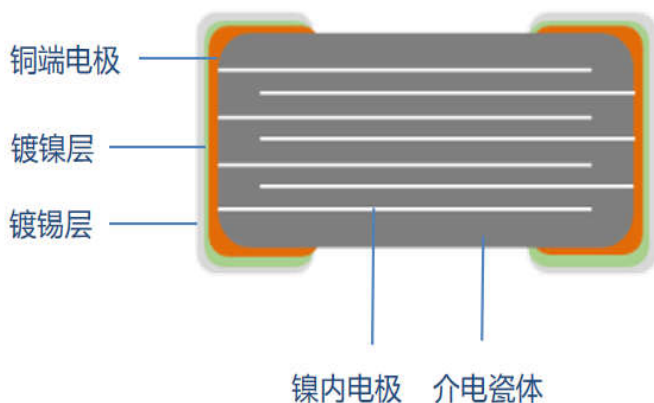
1

## ■ MLCC 用铜端电极浆料

### ◆ 特征

- \* 红色膏状流体，主要由铜粉、玻璃粉和有机黏合剂组成。
- \* 不含铅、镉、六价铬等禁用物质，符合 RoHS 指令环保要求。
- \* 应用于 BME-MLCC，作端电极用。

### ◆ 产品在 MLCC 中应用示意图及产品图片



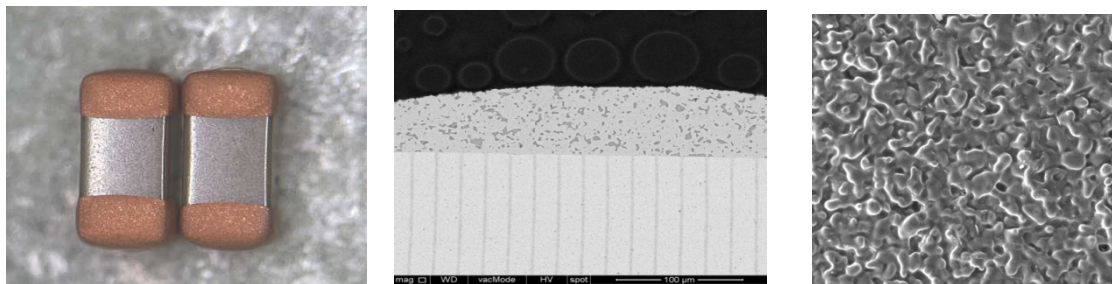
### ◆ 物理性能

型号	固含量 (%)	粘度* (Pa·S)	细度	适用性
CB06	82.5±1.5	20.0~30.0	≤8.0 μm	X7R 材料, 0201-1210 规格
CB75	80.5±1.0	26.0~32.0	≤8.0 μm	X7R、COG 材料, 0402-1812 规格
CN31	82.4±1.5	20.0~30.0	≤8.0 μm	COG 材料, 0402-0805 规格
CF63	79.8±1.0	25.0~31.0	≤8.0 μm	Y5V、X7R 材料, 0402-1812 规格
CF63A	80.3±1.0	35.0~45.0	≤8.0 μm	X7R 材料, 0201-1210 规格

(注\*: 粘度检测条件为 Brookfield HBDV-II +, CP52, 10rpm, 25±0.5℃)

### ◆ 产品特点

- \* 烧结后端头铜层致密性好。
- \* 导电率高。
- \* 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高。



### ◆ 推荐工艺

- \* 搅 拌：使用前慢速搅拌均匀。
- \* 封 端：用匹配的设备及技术参数进行封端。
- \* 干 燥：链式烘炉（适量抽风），100~110℃(峰值温度)，25~30min（全程时间）。  
因设备差异，客户可根据实际情况适当调试温度。
- \* 烧 结：在保护气氛下烧结，根据瓷体体系选择具体的烧结温度。建议烧结温度如下：

型号	烧结峰值温度 (°C)	峰值时间 (min)
CB06	765±10	7.5~10
CB75	855±10	10~20
CN31	755±10	10~20
CF63	930±10	10~20
CF63A	930±10	10~20

### ◆ 产品使用注意事项

- \* 电 镀：适用于氨基磺酸体系的电镀液。
- \* 清 洗：建议使用无水乙醇。
- \* 储存条件：建议在温度 18~25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
- \* 有 效 期：建议在符合上述储存条件下三个月内使用。
- \* 包装规范：采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 1500g/瓶。